

2026年7月，全球印制电路板产业投资热度维持高位，新增签约、立项及投资并购项目保持活跃。国内市场扩产动能较强，投资重点进一步向AI算力用高阶PCB、封装基板以及铜箔、电子布、覆铜板等关键材料集中，投资并购活跃。

国内投资，7月投资项目数量保持高位。如图1所示，截至2026年7月底，国内PCB企业投资（含在建）项目共308项，7月份新增28项PCB相关投资项目，其中签约20项、投资并购8项；按产业环节划分，PCB制造11项、材料11项、设备6项。7月份新增投资金额（仅包含披露金额）约470.3亿元人民币。重点项目包括鹏鼎控股拟127.3亿元在淮安建设AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目；红板科技拟在江西推进高阶mSAP、HDI技改及厂房建设项目，披露投资上限合计60亿元；联茂电子拟8亿美元在无锡建设AI算力高端电子基板材料研发制造总部项目；生益科技、耀鸿电子分别拟50亿元在苏州、无锡建设AI算力及高速主板核心材料项目；德福科技、金安国纪、杭电股份等围绕电子电路铜箔、覆铜板及半固化片加快扩产。

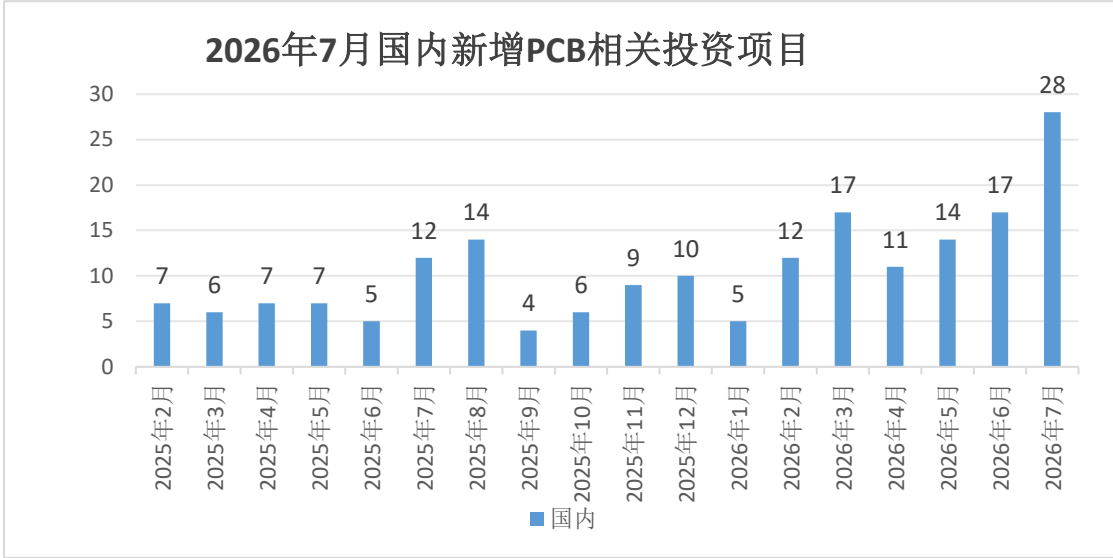


图 1 2026 年 7 月国内新增 PCB 相关投资项目

表 1 2026 年 7 月国内新增 PCB 及相关投资项目

投资规模（亿元人民币）						
分类	公司名称	项目名称	投资地	投资地	币)	类型
材料	德福科技	5 万吨人工智能高端电子电路 AI 铜箔项目	江西	九江	22.5	签约
PCB	崇鼎明宏	高端线路板项目	广东	茂名	10	签约
材料	众邦新材料	年产 19 万吨电子级环氧树脂项目	安徽	黄山	10.8	签约
PCB	威尔高	年产 144 万平方米高端 AI 类 PCB 智能制造项目	江西	井冈山	7.48	签约
PCB	敬鹏电子	AI 暨车载智驾 HDI 核心基板项目	江苏	常熟	6.75	签约
设备	泰科思特	东莞智造总部项目	广东	东莞	10	签约
材料	永冠新材	电子级玻璃纤维布项目	江西	抚州	3	签约
PCB	红板科技	高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目	江西	赣州	50	签约
PCB	红板科技	高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目	江西	吉安	7	签约
PCB	红板科技	赣州红板 D1 栋厂房及辅助设施建设项目	江西	赣州	3	签约

材料	生益科技	AI 高性能算力及先进半导体基材研发生产基地	江苏	苏州	50	签约
材料	容大感光	广州生产基地建设项目	广东	广州	2.3	签约
PCB	鹏鼎控股	庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目	江苏	淮安	127.3	签约
PCB	松胜电路	年产 50 万平方米 PCB 线路板项目	广西	贵港	1.5	签约
PCB	博敏电子	800G 及以上数连产品用印制电路板项目	江苏	盐城	2.99	签约
材料	联茂电子	AI 算力高端电子基板材料研发制造总部项目	江苏	无锡	54.01	签约
材料	杭电股份	年产 3 万吨人工智能用高端电子电路铜箔项目	江西	南昌	14.99	签约
材料	金安国纪	珠海国纪增资扩产项目	广东	珠海	20	签约
材料	凯盛科技	TGV 先进封装玻璃中试线	安徽	蚌埠	1.5	签约
材料	耀鸿电子	AI 智算高速主板核心材料研发生产基地项目	江苏	无锡	50	签约
设备	鼎泰高科	出资设立广东鼎泰真空镀膜技术有限公司	广东	东莞	0.475	投资并购
设备	新锐股份	收购新乡市慧联电子科技有限公司 80%股权	河南	新乡	8	投资并购
材料	三孚新科	参设广州德胜洋电子材料制造有限公司	广东	广州	0.5	投资并购
设备	中岩大地	收购深圳市鑫寰宇精工科技有限公司 60%股权	广东	深圳	2.4	投资并购
设备	民爆光电	收购厦芝精密 49%股权	福建	厦门	2.35	投资并购
设备	TTST、FUSEI MENIX	组建中国合资公司	中国	未披露	未披露	投资并购
PCB	贤丰控股、广东盈硕	设立合资 PCB 企业	广东	惠州	1.18	投资并购
PCB	天工国际、铭创金投、梵宇科技	设立合资公司江苏天工电子科技有限公司	江苏	丹阳	0.3	投资并购

国际投资，7 月整体投资项目数量保持活跃。如图 2 所

示，2026 年 7 月，国际新增 PCB 相关投资 10 项，其中签约 8 项、投资并购 2 项，项目主要分布在越南、泰国、韩国及欧洲，披露投资金额约 156.0 亿元人民币。重点项目包括 LG Innotek 拟 10 亿美元（折合约 67.5 亿元人民币）在越南海防建设半导体封装基板制造工厂；斗山集团、联茂科技和富乔分别拟投资 60 亿泰铢（折合约 12.1 亿元人民币）、63 亿泰铢（折合约 12.7 亿元人民币）和 33.1 亿泰铢（折合约 6.7 亿元人民币），在泰国建设半固化片、覆铜板及玻璃纤维布项目；韩国 TLB 拟 2000 亿韩元（折合约 9.4 亿元人民币）建设越南北宁二期工厂，大德电子拟 4970 亿韩元（折合约 23.2 亿元人民币）扩建韩国半导体封装基板生产设施；三星电机与东宇精细化学拟共同投资 3191 亿韩元（折合约 14.9 亿元人民币）成立玻璃基板合资企业 Glass em；Somacis 拟收购欧洲 Group ACB，投资金额未披露。

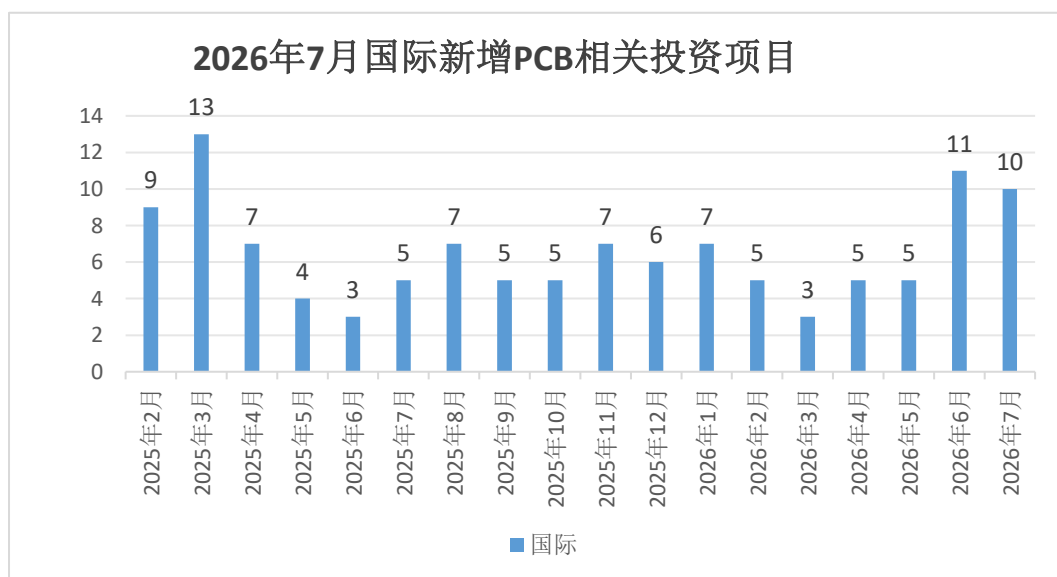


图 2 2026 年 7 月国际新增 PCB 相关投资项目

CPCA

中国电子电路行业协会
CHINA PRINTED CIRCUIT ASSOCIATION

地址：上海市闵行区都会路2338号95号楼3楼CPCA总部大厦
CPCA Headquarters (Building No. 95), Headquarters No.1 Block,
2338 Duhui Road, Minhang District, Shanghai, China 201108
电话/Tel: 0086-21-54179011, 54179012
传真/Fax: 0086-21-54179002 邮政编码: 201108
E-mail: cpca@cpca.org.cn Web site: www.cPCA.org.cn

更多精彩内容请扫描下方二维码，关注 CPCA 服务号

撰稿人：张国旗

审核：张运



CPCA SHOWPLUS 2026电子半导体产业创新发展大会
暨国际电子电路（大湾区）展览会
ELECTRONIC SEMICONDUCTOR INDUSTRY INNOVATION & DEVELOPMENT SUMMIT INTERNATIONAL ELECTRONIC CIRCUITS (GBA) EXHIBITION



科创领航 链接未来
INNOVATION LINKS THE FUTURE

主办单位：中国电子电路行业协会
Organizer: China Printed Circuit Association

2026
10.27-10.29
深圳国际会展中心(宝安)
Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao'an)



CPCA展会服务号 扫码申请2026展位

CPCA展会工作部
章先生：86-130 4567 9193
沈先生：86-130 4567 7353
www.cpcashowplus.com